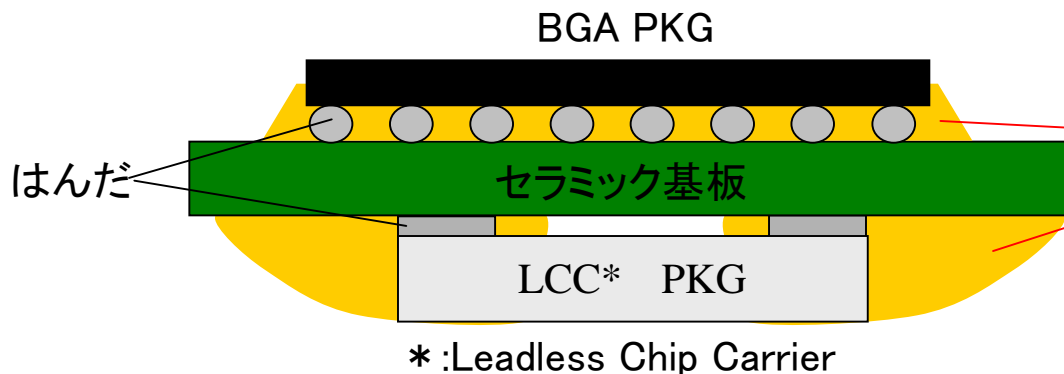


低温硬化/ミラー実装対応アンダーフィル



* :Leadless Chip Carrier

ミラー実装部断面

アンダー
フィル

- ・両面実装:耐高ストレス
- ・低温硬化:80°C

・高密着強度

実装部材と反応性が高いエポキシ樹脂
やカップリング剤を適用

・低熱膨張化

樹脂中への無機フィラーの高密度充填

・低温硬化組成

低温反応型硬化促進剤の適用
組成適正化

10年以上の信頼性を確保

(開発品のみ満足)

TCT: -40°C~85°C、3000cyc

HT: 125°C、1500h

LT: -40°C、1500h

HHB: 85°C、85%、1500h